

2016年6月14日
维亚机械（株）

维亚机械（株）印刷线路基板用 新型镭射钻孔机销售的公告 实现高精度，高生产效率的新一代封装基板加工

印刷电路板加工设备厂商维亚机械（株）在2016年6月20日，发布了新一代印刷电路板镭射钻孔机，正式开始销售面向高端封装基板加工的LC-4NT252。

【开发背景】

伴随着智能手机等高端电子产品中使用的元器件快速进化，完全有别于原来钻孔技术的超高精度要求在增多。

作为新一代技术的解决方案，我司合全公司智慧力量研究开发，引满而发投入市场，业界最高位的新机型就是LC-4NT252。

【特长】

1. 业界最高等级的高精度。

机械本体设计的根本改进，以及高度的校正技术实现了可匹敌晶圆级PKG加工的超高精度。

Glass Master校准精度： $Ave.+4\sigma \leq 8\mu m$

2. 业界最快，20,000穴/秒的压倒性超高生产效率（跟我司当前型号比180%）。

铜直接镭射中业界第一台双台面四光束加工机。搭载高输出功率镭射头以及新光路设计等加工控制的进化使得加工效率飞速提高。

3. 提高精度稳定性。

为实现加工稳定性，从高刚性设计的本体，以及镭射发振器，扫描镜等关键部件，对所有要素进行最优化，从而同时实现超高精度和长时间加工稳定性。

4. 加工条件选定助手。

搭载了积蓄了我司长年的加工经验，加工技术的最新软件，自动生成最适合的加工条件供使用者选择。



快速进化的基板加工工程需要对应各种各样的加工要求。

我司在2016年中，预定开始销售全新的2个机种及新设备。

敬请期待一直发布[最新]的维亚机械技术。

关于本设备的咨询联系方式：

维亚机械（株） 经营战略本部 市场部

松橋安里 e-mail:a.matsuhashi@viamechanics.com

Tel:046-235-9714

ピアメカニクス株式会社

神奈川県海老名市上今泉2100番地 〒243-0488 Tel:046-235-7111 Fax:046-232-8984 URL: <http://www.viamechanics.com>